

广东省科学院半导体研究所封装应用平台实验室 建设项目施工单位遴选公告

广东省科学院半导体研究所封装应用平台实验室建设项目施工公开遴选，欢迎符合资格条件的施工单位参加。有关事项如下：

一、项目的名称、内容、最高限价

(一) 项目名称：广东省科学院半导体研究所封装应用平台实验室建设项目（项目编号：BDT2024090501）

(二) 项目内容及要求：

1、本项目为 161 园区封装应用平台科研实验室项目的装修施工。

2、项目要求：

(1) 封装应用平台实验室建设-施工图

(2) 封装应用平台实验室装修项目工程量清单

(三) 本项目最高限价为人民币壹拾捌万元整（¥180,000.00）

二、遴选条件

(一) 参与单位必须是在中华人民共和国合法注册的独立法人，经行政主管部门核准具有从事本项目的经营范围和能力。供应商必须提供有效营业执照(或事业法人登记证)(副本)复印件、组织机构代码证(副本)以及税务登记证(副本)复印件(三证合一供应商只需提供有效的营业执照（或事业法人登记证）副本复印件）。

(二) 参与单位具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(三) 供应商须是广东政府采购智慧云平台电子卖场（<https://gdgpo.czt.gd.gov.cn/provide/index?platform=3&sour>

ce=31) 定点集市“装修工程”类的供应商，且服务区域包含广州市；
(提供平台网站查询截图证明)

(四) 本项目不允许联合体投标，同时项目投标人须同意被遴选出后作为广东政府采购智慧云平台供应商进行装修工程定点采购定点议价。

三、递交资料及报价时间、遴选时间

(一) 递交资料及报价时间：2024 年 9 月 9 日至 2024 年 9 月 15 日

(二) 递交地址：广州市天河区长兴路 363 号 半导体所 1 栋 318 室

(三) 遴选时间：2024 年 9 月 18 日

四、联系人及联系方式

联系人：黄工

联系电话：020-87716075-8023

广东省科学院半导体研究所

2024 年 9 月 9 日



封装应用平台实验室建设工程量清单



编号	项目名称	单位	工程 量	其中综合单价构		单价	合价
				人工费	材料费		
一、增加装修项目							
1	拆除局部通道地面瓷砖	m ²	21				
2	拆除200厚墙砖	m ²	24				
3	拆除局部天花	m ²	21				
4	拆除消防门安装不锈钢门套	m	6				
5	封门	个	1				
6	新建轻钢龙骨间墙	m ²	44				
7	房间做夹板石膏板吊装间墙	m	14				
8	铝合金高间隔间墙	m ²	43				
9	铝合金高间隔墙单开门	樘	3				
10	双开木门	扇	2				
11	双开玻璃门	扇	2				
12	地面做水泥沙（实验室）比贴 砖水泥沙多出部分	m ²	129				
13	地面做自流平（实验室）	m ²	129				
14	地面做防静电地坪漆（实验 室）	m ²	129				
15	强电改造	m ²	296				
16	弱电重新排管布线	m ²	296				
17	遮光卷帘	m ²	83				
18	卫生保洁	项	1				
19	装修垃圾外运	项	1				
20	门禁系统	项	1				
包干含税总价							